

半導體工程系 四技 112 學年度入學課程結構規劃表

課程類別	一年級						二年級						三年級						四年級							
	第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期				
	課程名稱	學分	時數	課程名稱	學分	時數	課程名稱	學分	時數	課程名稱	學分	時數	課程名稱	學分	時數	課程名稱	學分	時數	課程名稱	學分	時數	課程名稱	學分	時數		
校共同必修課程	應修學分數	12學分																								
	中文閱讀與表達(一)	2	2	中文閱讀與表達(二)	2	2																				
	實用英文(一)	2	2	實用英文(二)	2	2	實用英文(三)	2	2	實用英文(四)	2	2														
	體育(一)	0	2	體育(二)	0	2	體育(三)	0	2	體育(四)	0	2														
校訂通識	基礎探索入門	應修學分數至少2學分																								
	人文與創意美感	博雅通識/學分數/時數																								
	科技與數位知能	博雅通識/學分數/時數																								
	社會與身心關懷	博雅通識/學分數/時數																								
博雅通識	歷史與多元思維	博雅通識/學分數/時數																								
	全球與永續議題	博雅通識/學分數/時數																								
	通識微學分	通識微學分(一)1、通識微學分(二)1、通識微學分(三)1、通識微學分(四)1、通識微學分(五)1、通識微學分(六)1、通識微學分(七)1、通識微學分(八)1、通識微學分(九)1、通識微學分(十)1																								
	學院共同課程(由學院開課)	選修	工程實作實習/3/3																							
學院時領域課程(由學院開課)	選修	光：訊號與能源/3/3 機器人程式編程與演算法概念/2/2 虛擬實境互動實務/1/3 3D列印實務/1/3 智慧科技應用專論/3/3 車用電子應用及實務/3/3 機光電半導體封測/3/3																								
	必修	應修課程數	22門/																							
		應修學分數	55學分																							
		電路學(一)	3	3	電路學(二)	3	3	電子學(二)	3	3	電磁學(一)	3	3	半導體製程與設備	3	3	實務專題(一)	2	4	實務專題(二)	2	4				
系專業課程	選修	應修學分數至少45學分	半導體產業介紹/2/2 科技英文/3/3						向量分析/2/2 線性代數/3/3 半導體元件(二)/3/3 光電半導體元件/2/2 微控制器實習/1/3 射頻電路設計與實習(一)/3/3 嵌入式系統實習/2/3 虛擬圖控儀表實習/2/3 可程式邏輯控制實習/2/3 電腦網路概論/3/3 VLSI工具實務/2/2 專案實習/3/3 暑期實習-產業實習/3/3						感測元件暨電路分析/2/2 感測元件應用電路實習/2/3 光電元件量測暨封裝實習/2/3 單晶片實驗/3/3 半導體設備真空系統實務/3/3 Python程式設計與實習/2/3 射頻電路設計與實習(二)/3/3 太陽能光電技術/3/3 太陽能電池製程與應用/3/3 數位訊號處理/3/3 VLSI電路設計實習(一)/3/3 VLSI電路設計實習(二)/3/3 半導體量測實驗/2/3 半導體奈米技術/3/3 半導體製程設備實務培訓/3/3 半導體材料科學/3/3 半導體負電阻元件/3/3 半導體無塵室技術/3/3 半導體設備基礎技能實務/3/3 半導體設備元件儀控系統實務/3/3 半導體元件製程與特性模擬/3/3 半導體產業技術問題與實習導向/3/3 半導體產業實務見習與建結微學分/1/1 電磁學(二)/3/3 複變函數/3/3 機率/3/3 專案實習/3/3 暑期實習-產業實習/3/3 學期實習-產業實習/9/9 學年實習-產業實習/9/9						電源管理晶片設計與實習/3/3 發光二極體元件及其應用/3/3 感測網路應用實務/3/3 真空技術/3/3 生物感測/3/3 磊晶工程/3/3 薄膜技術/3/3 自動控制/3/3 微機電製程/3/3 液晶平面顯示器/3/3 類比電路設計/3/3 訊號與系統/3/3 奈米生醫感測/3/3 大數據資料庫應用實務/3/3 半導體設備/3/3 半導體評估技術/3/3 半導體構裝材料與製程簡介/3/3 半導體元件製程與特性模擬/3/3 產業問題導向學習/3/3 產業實務見習與建結/1/1 半導體產業技術問題與實習導向/3/3 半導體產業實務見習與建結微學分/1/1 專案實習/3/3 暑期實習-產業實習/3/3 學期實習-產業實習/9/9 學年實習-產業實習/9/9					

備註：
一、畢業總學分數為 128 學分。
二、必修 55 學分，選修 45 學分。(不含校共同必修課程及通識課程的學分數)

(接續背面)



